

2026 年 3 月 27 日

致各位

公司名 尼得科精密检测科技株式会社
代表人 董事长、总经理 山崎秀合
所在地 日本京都府向日市森本町东之口 1-1
Nidec Park C 栋

尼得科与 Technohorizon 株式会社合作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
～一台设备即可实现行业高水平的高速检测与高精度解析，满足数据中心市场的需求～

尼得科精密检测科技株式会社（以下简称“本公司”）近日与 Technohorizon 株式会社（总部：日本爱知县名古屋市，董事长：野村扩伸，以下简称“Technohorizon”）达成合作，宣布将携手面向高速增长的人工智能服务器及数据中心市场，联合开发一款可对多层印制电路板的背钻加工进行高精度、高速检测的新产品——“自动 X 射线检测设备（AXI）”。



2026 年 3 月 5 日在尼得科精密检测科技总部（向日市）举办的签约仪式

（左）Technohorizon 董事长、总经理 野村扩伸 （右）尼得科精密检测科技株式会社董事长、总经理 山崎秀和

■合作背景

近年来，随着生成式人工智能的普及以及数字化转型（DX）的加速，数据中心及 AI 服务器市场实现了快速扩张。为实现大容量、高速数据通信，搭载于这些设备的高性能服务器采用了高层数、高密度的印制电路板。在这类高速传输电路板中，通孔等核心工序的加工效果是影响电路板品质的关键因素之一，而“背钻工艺”的质量检测重要性也较以往大幅提升。在此背景下，市场对能够实现无损、精准检测，且适配量产生产节拍时间的检测解决方案产生了大量需求。

■合作目的及愿景

本次开发的新产品，兼顾了可适配量产线全检需求的“行业高水平检测速度”，以及能够满足不良品解析与研发工作的“高精度成像能力”。同时，通过使以往 X 射线检测设备中成为瓶颈的检测程序设定更加简化和自动化、缩短检测时间、实现检测判定自动化等改进，该产品可适配量产产线的运行模式，以应对激增的 AI 服务器市场需求。

依托的 Technohorizon 高灵敏度、高分辨率 X 射线成像技术，可对背钻加工的剩余厚度（残桩长度）以微米级单位进行可视化与测量。由此，不仅可在量产阶段进行良率判定，一台设备即可完成试制阶段的工艺条件设定、以及不良发生时的详细分析。此外，本公司作为印制电路板检测设备（导通检测、光学检测等）的头部企业，具备高精度测量技术，以及实现检测工序自动化、省力化的机电一体化技术优势。在本次合作中，我们将提供设备整体的系统集成、以及全球化的销售与支持网络。两家公司将通过本产品的市场投放，为支撑 AI 社会基础设施的高品质电子产品制造贡献力量。

■关于 Technohorizon 株式会社

公司以影像&IT 技术、以及实现电机高效运行的机器人技术为核心，在工业 X 射线检测设备领域同样拥有出色业绩。凭借独有的 X 射线生成与探测技术、以及基于高度算法的图像处理技术，形成了核心技术优势。

官网：<https://www.technohorizon.co.jp/>

■关于尼得科精密检测科技株式会社

尼得科精密检测科技是一家综合型测量与检测技术制造商。主力业务为印刷电路板和半导体封装基板的通电检测设备，凭借高速、高精度的检测技术赢得了全球客户的高度信赖。除了传统的电气检测外，公司还积极强化基于光学技术的外观检测设备与特殊检测设备产品线，广泛应用于功率半导体、电动汽车电机等领域。

官网：<https://www.nidec.com/jp/nidec-advancetechnology/>